

- 開催まであと1週間となりました。日帰りワークショップの参加を受け付けています。レセプションは定員となり締切となりましたが、ナイトセッションからの参加希望を残り僅かですがお受けできます。
- 講演会では質問できないが1対1でもっと討議したいという希望を受け付け、ポスターをそろえました。また、業界の重鎮なる先生方をお呼びして前泊でナイトセッションを行います。

\*ナイトセッション(1日目) 「日本実装業界の将来像」

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| A. 友景 肇 氏 福岡大学 教授         | 「日本の半導体企業を変えよう」   |
| B. 湯之上隆 氏 微細加工研究所 所長      | 「産業競争力とは何か? どうしたら産業競争力向上するか?」                                       |
| C. 折井靖光 氏 日本IBM(株)東京基礎研究所 | 「半導体のスケールアップ則終焉にむけて実装技術者ができること」<br>~Cognitive Computer 時代をどう生き抜くのか~ |
| D. 杉山 進 氏 立命館大学 教授        | 「MEMS 基板材料の多様化による産業応用拡大への期待」<br>~可動部を有するポリマーMEMSの開発~                |
| E. 舟木 剛 氏 大阪大学大学院 教授      | 「パワーデバイスが産業のコメ, SiC/GaN はササニシキ/コシヒカリでもバランスよく食べなきゃ体に良くないですよ!」        |

\*ワークショップ(2日目)

講演会

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 友景 肇 氏 福岡大学 教授    | 「半導体徹底抗戦」                             |
| 湯之上隆 氏 微細加工研究所 所長 | <日本「半導体」敗戦の著者> 「TSV 対 EUV (微細加工)、その後」 |

特別講演

- 江藤 浩之 氏 京都大学 教授 iPS 細胞研究所 「iPS 細胞への投資を考える:この不思議な細胞は何ができるのか?」

ポスターセッション 30 件

●カーエレ・パワーエレクトロニクス

ポッティング封止型パワー半導体パッケージの開発  
 パワーモジュール関連実装材料 (仮)  
 今こそ、ギ酸還元はんだ付け  
 銀ナノ粒子および銀銅混合ナノ粒子ペーストのパワーデバイス接合評価  
 パワーデバイス用の高熱伝導薄膜フィルムの開発  
 小型 SiC パワーモジュールの産業化に向け、AIバンプを用いた  
 低コストフリップチップ実装の検討

三菱電機株式会社 小川翔平 氏  
 産業技術総合研究所 伊東宇一 氏  
 テクノアルファ株式会社 宇田紘太郎 氏  
 新電元工業株式会社 松林良 氏  
 ナミックス株式会社 高杉寛史 氏  
 技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス  
 研究開発機構 (FUPET) 谷澤秀和 氏

●プリンテッドエレクトロニクス

銀ナノ粒子インクをめっき下地とした銅配線形成技術  
 プラズマ処理効果の新規評価方法 プラズマケミカルインジケータ  
 低温・短時間焼成可能なCu錯体ペーストインク (仮)

D I C株式会社 白髪潤 村川昭 富士川亘 氏  
 株式会社サクラクレパス 大城盛作 氏  
 四国化成工業株式会社 飯田宗作 氏

●3Dインテグレーション

三次元積層向けウエハの裏面研削によるダメージ評価  
 ジェイデバイスのフリップチップ技術  
 2.5D実装のための、高密度配線を有する有機インターポーザの開発

東京工業大学 水島賢子 氏  
 株式会社ジェイデバイス 岩崎俊寛 氏  
 新光電気工業株式会社 清水規良 氏

●基板・部品内臓

2.5D インターポーザ用高密度有機配線基板 AdvancedPackageX の開発(仮)  
 熱電モジュール・センサを実現するPALAP最新技術  
 高周波プリント基板用低誘電ポリイミド樹脂 (仮)

京セラ SLC テクノロジー(株) 湯川英敏 氏  
 デンソー株式会社 矢崎芳太郎 氏  
 荒川化学工業株式会社 塩谷淳 氏

●インターコネクション

高効率 III-V 多接合太陽電池セルのための Ge/GaAs の直接接合  
 接着剤併用型 Sn-Bi はんだペースト  
 はんだ接合部エレクトロマイグレーションの信頼性: 分かった事、分からない事

東京大学 須賀研究室 河野元紀 氏  
 富士通クオリティ・ラボ 北村和大 氏  
 中京大学 教授 山中公博 氏

●新材料

高熱伝導性複合材料の開発とその応用(仮)  
 耐熱性仮貼り材料の開発  
 曲がる・割れない有機透明導電フィルムの開発 (仮)

住友精密工業株式会社 伊藤洋平 氏  
 東レ株式会社 電子情報材料研究所 藤原健典 氏  
 長岡産業株式会社 長岡利典 氏

●めっき

パラジウム触媒を含んだポリシリセスキオキサン薄膜上への無電解銅めっきの形成  
 TSV 形成を目的とした電解銅めっき中における中間体 Cu<sup>+</sup>のめっき促進作用の解析

奥野製薬工業株式会社 村橋浩一郎 氏  
 大阪府立大学 近藤研究室 林太郎 氏

●MEMS

MEMS センサー (絶対圧センサ)  
 MEMS センサー (環境複合センサ)  
 微小金属トーションバネの超高サイクル疲労特性評価  
 幅広い MEMS プロセスを有する試作・量産ファンドリ

オムロン株式会社 春山隆之 氏  
 オムロン株式会社 柿谷淳也 氏  
 立命館大学 上野明 氏  
 丸紅情報システムズ(株) 武田弘高 氏

●装置技術

工業用インクジェットを成功させる秘訣と失敗する理由  
 薄膜ウェット塗布装置 エレクトロスプレーコータ  
 道具としての3Dプリンター、ひとつものづくりについて

株式会社石井表記 小澤康博 氏  
 東レエンジニアリング(株) 畠山辰男 氏  
 ビークル株式会社 片岡豪太 氏

# 関西ワークショップ2014

日時 2014年 7/17(木) 18:00 ~ 7/18(金) 18:00  
 開催場所 ラフォーレ琵琶湖 滋賀県守山市今浜町十軒屋 2876 077-585-3811  
 参加費 ●ワークショップ 日帰り1日コース 19,800円 前日締切  
 (昼食費は含まれません)

●ナイトセッションから参加 前泊2日間コース 29,800円 7/14午前締切

〔\*レセプションは定員となり締め切りました。 35,000円を29,800円で受け付けます。  
 \* ナイトセッション \* 宿泊費(グループ毎相部屋。男女別)  
 \* 2日目ワークショップ参加費 (朝食、昼食費は含まれません) 〕

\*前泊は 7/14 午前締切。ワークショップは前日まで受け付けますが、当日は現地にて申し込み下さい。但し、トータル100名になり次第締め切らせて頂きます。  
 \*上記は会員、協賛団体会員価格となります。非会員の方は+10,000円の加算額となります。

7/17 (木)		7/18 (金)	
15:00~18:00	チェックイン	8:00~ 8:30	モーニングセッション
18:00~20:00	レセプション (立食形式)	8:45~ 9:00	2日目受付
20:00~21:00	ナイトセッション1部 (講師5名のショート講演)	9:00~10:00	ポスター アブストラクト トーク
21:00~22:00	ナイトセッション2部 (各講師毎のグループへ分かれて討議)	10:00~11:00	講演会 第1部
22:00~	ナイトセッション3部 (各講師5部屋へ移動 自由集合)	11:00~12:00	講演会 第2部
		12:00~13:00	昼休憩 (自由時間)
		13:00~16:30	ポスターセッション
		16:30~17:30	特別講演

## 予定



<h3>宿泊</h3> <p>GUEST ROOMS リゾート感溢れる客室</p> <p>琵琶湖を一望する贅沢なロケーションのお部屋や、カジュアルにお過ごしいただけるお部屋などをご用意。ご滞在スタイルにあわせてお選びください。</p> <p>総合リゾートホテル ラフォーレ琵琶湖</p>	<h3>自由時間</h3> <p>FACILITIES 多彩な付帯施設</p> <p>国内ホテルで唯一の本格的プラネタリウムは、迫力映像とサウンドが自慢。その他、体育館やプール、テニスなどのスポーツ施設も充実しています。</p>	<h3>交通機関</h3>
---	--	---------------

\*湖西線堅田駅(京都から19分)より送迎有・・・ 7月18日 16:30 7月19日 8:30 終了時18:00 堅田駅行  
 琵琶湖線守山駅 近江バス 守山駅発・・・ 8:30・・・14:45 15:45 16:45 17:46・・・  
 ラフォーレ 発・・・ 18:20・・・

主催 エレクトロニクス実装学会 関西支部

お問い合わせは Tel・Fax 06-6879-4598 E-mail:kansai@jiep.or.jp

〔協賛予定(交渉予定) 社団法人日本ロボット工業会(JARA)、社団法人日本電子回路工業会(JPCA)、表面技術協会、日本機械学会、溶接学会マイクロ接合研究委員会、日本材料学会、日本信頼性学会、日本金属学会、日本接着学会。〕

\*講師、内容は変更になる場合があります。また、ご希望のセッションが選定されない場合もありますので予めご了承ください。  
 \*シングルご希望の方は追加料金必要ですが数名まで受け付けられます。

FAX (06-6879-4598)

## 関西 WS2014 参加 申込書 (開催2014年7月17, 18日)

参加コース 前泊2日間コース・日帰り1日コース

氏名 (フリガナ)

勤務先

所属(役職)

住所 〒

TEL/FAX

E-mail

●希望ナイトセッション(A~E) 講師名  
 (宿泊2日間コースの場合のみ)

正会員 (会員番号 )

賛助会員 (会員番号 )

協賛団体 (会員番号 )

団体名 \_\_\_\_\_

一般

学生一般